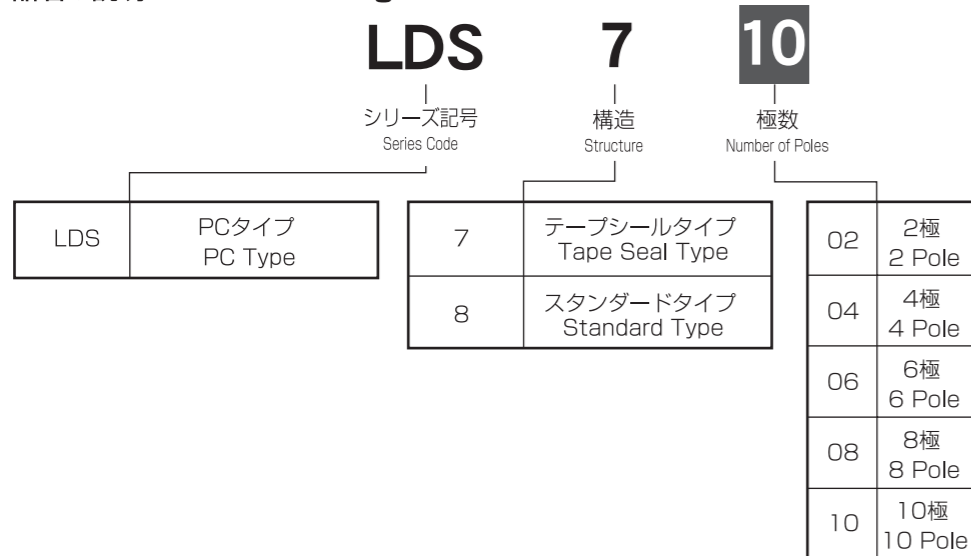


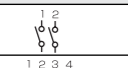
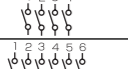



DIP シリーズ Series	品名	超薄形ディップスイッチ LDS7	
	端子部形状	Terminal Style P/Cタイプ PC	
Part No.		Ultra-Low Profile DIP Switches	

仕様 Specifications

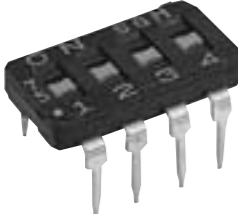
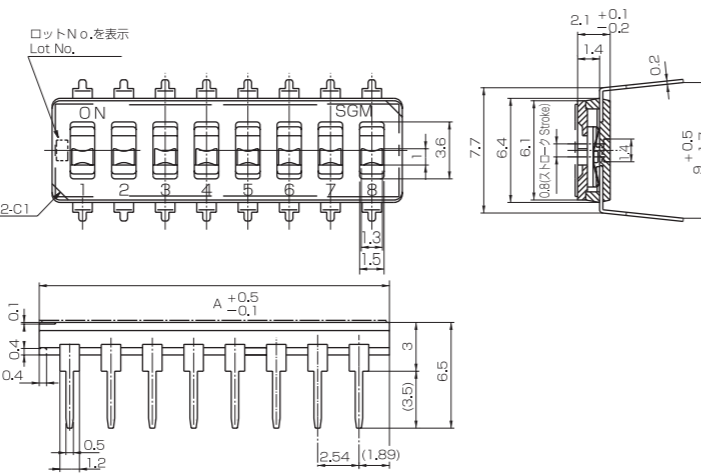
定格	最大定格 DC50V 100mA 最小定格 DC20mV 1μA	Rating	100mA 50V DC Max. 1μA 20mV DC Min.
初期接触抵抗	50mΩ以下(AC200μV 1.5mA)	Initial Contact Resistance	50mΩ Max.(1.5mA 200μV AC)
初期耐電圧	AC500V 1分間	Initial Dielectric Strength	500V AC 1minute
初期絶縁抵抗	1,000MΩ以上(DC100V)	Initial Insulation Resistance	1,000MΩ Min.(100V DC)
電気的寿命	1,000回	Electrical Life	1,000 Cycles.
動作力	0.49~5.88N(0.05~0.6kgf)	Operating Force	0.49~5.88N(0.05~0.6kgf)
使用温度範囲	-25~+80℃	Operating Temperature Range	-25~+80℃
保存温度範囲	-40~+80℃	Storage Temperature Range	-40~+80℃

品名の説明 Part Numbering


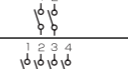

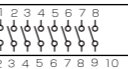
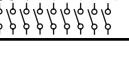


品名 Part No.	回路図 Circuit	極数 Number of Poles	A寸法 Dimension A
LDS702		2	6.30
LDS704		4	11.40
LDS706		6	16.45
LDS708		8	21.55
LDS710		10	26.60

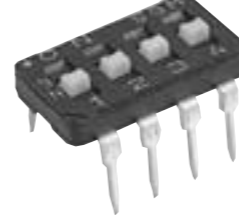
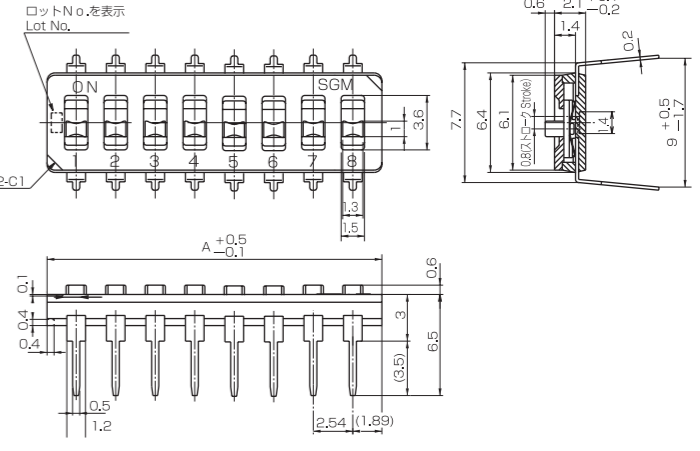
超薄形ディップスイッチ LDS7
テープシールタイプ
Tape Seal Type

DIP シリーズ Series	品名	超薄形ディップスイッチ LDS8	
	端子部形状	Terminal Style P/Cタイプ PC	
Part No.		Ultra-Low Profile DIP Switches	

品名 Part No.	回路図 Circuit	極数 Number of Poles	A寸法 Dimension A
LDS802		2	6.30
LDS804		4	11.40
LDS806		6	16.45
LDS808		8	21.55
LDS810		10	26.60

超薄形ディップスイッチ LDS8
スタンダードタイプ
Standard Type

1. はんだ付け仕様/Soldering Requirements

- 手付け/Hand Soldering
 - コテ先温度350℃以下 3秒以内。 350℃ 3 sec. max.
 - コテ先温度270℃以下 5秒以内。 270℃ 5 sec. max.
- フローライン/Auto Soldering

装置：噴流式または浸漬式260℃ 5秒以内
Device: jet wave or dip type 260℃ 5sec. max.

2. 洗浄仕様/Cleaning

- はんだ付け後はスイッチの温度が70℃以下になってから洗浄してください。
Be sure to do the cleaning when switch temperature drops to 70℃ or lower.
- 丸洗い洗浄(浸漬洗浄)は液温が50℃以下で洗浄してください。
Immersion cleaning (dipped cleaning) should be done when solution temperature is 50℃ or lower.

3. スイッチ操作およびテープ貼り付けについて/
Operating Actuators and Tape Sealing

- 操作はピンセット、ボールペン等で行ってください。
Use tweezers or ball-point pens to operate actuators.
- ツマミに2kgf以上の力(図の矢印方向)を加えないでください。ツマミが変形し接触不良の原因になります。
Don't apply an excessive force of 2kgf or more to the arrow-marked directions of actuators. Otherwise, the actuators might be deformed, causing contact failures.
- テープを剥がして再度貼り付けると、粘着力が弱くなりフラックスの流入の原因になります。
Once tape removed, don't re-seal it. Otherwise flux may flow into the switch enclosure due to the weakened adhesive, causing contact failure.

4. 包装仕様/Packaging Information/Ordering

- スティック仕様 (スティック1本当りの個数)
Stick Packaging (Quantity/Stick)

品名 Part No.	極数 Pole	2	4	6	8	10
LDS7	数量	72	40	28	20	16
LDS8	Q'ty					

プリント基板取付ラウンド寸法(参考)
PC Hole Layout